

智慧電子人才應用發展推動計畫

109 年度短期在職訓練班入選班級

◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
1	三建資訊有限公司	【日本專家】Mini/Micro LED 最新動向與設計挑戰	120,000
2	三建資訊有限公司	【日本專家】環氧樹脂用硬化劑・硬化物的分析技術	120,000
3	三建資訊有限公司	【日本專家】5G/Beyond 5G 所要求的高頻材料技術動向	120,000
4	三建資訊有限公司	【日本專家】如何透過架橋技術提高黏著性及改良法	120,000
5	三建資訊有限公司	【日本專家】靈活運用聚醯亞胺・達成各式高機能化及透明性應用	120,000
6	三建資訊有限公司	【日本專家】邁向異質整合 3D-IC 先進製程挑戰	120,000
7	三建資訊有限公司	【日本專家】次世代毫米波 5G 系統及其對應材料的評價技術	120,000
8	三建資訊有限公司	【日本專家】應用於 5G 低誘電率樹脂的真空電漿表面改質	120,000
9	三建資訊有限公司	【日本專家】擴大中的 FOWLP/FOPLP 封裝新世代	120,000
10	工業技術研究院	製造自動化與機器人實務培訓班	100,000
11	工業技術研究院	量測與校正實務培訓班	100,000
12	工業技術研究院	靜電放電(ESD)防護設計與測試驗證培訓班	100,000
13	工業技術研究院	永磁無刷馬達之分析、設計與實例模擬	100,000
14	工業技術研究院	啟動 AI ~ 物聯網系統規劃、建置與應用實作培訓班	100,000
15	工業技術研究院	產線電磁干擾(EMI)防制設計與接地工程培訓班	100,000
16	工業技術研究院	六標準差 GB 綠帶實務班(含 Minitab 及 R 軟體實作)	100,000

¹ 政府經費以每班 20 人估計，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
17	工業技術研究院	深度學習與 NVIDIA Jetson Nano 自駕車應用實戰班	100,000
18	工業技術研究院	第五代行動通訊之天線陣列技術(實作)	90,000
19	工業技術研究院	產品環境試驗與加速壽命試驗培訓班	100,000
20	中華大學學校財團法人中華大學	穿戴式物聯網設計概論	100,000
21	中華大學學校財團法人中華大學	穿戴式物聯網的感知技術	100,000
22	中華行動數位科技有限公司	物聯網應用設計	240,000
23	中華行動數位科技有限公司	AI 物件偵測應用及實作	240,000
24	中華行動數位科技有限公司	ROS 自駕車系統應用	200,000
25	台大慶齡工業研究中心	訊號及電源完整性實務	100,000
26	台大慶齡工業研究中心	晶片至系統電磁相容實務	120,000
27	台大慶齡工業研究中心	5G 毫米波收發系統與電路設計實務	100,000
28	台大慶齡工業研究中心	5G 與次世代天線設計與驗測實務	100,000
29	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED 照明與光環境設計照明與光環境設計實作班(4.13 版)	100,000
30	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED(二次)光學元件設計與效能模擬實務班	80,000
31	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED 照明與光環境設計實作班(EVO 版)	100,000
32	台灣區照明燈具輸出業同業公會	適應性車燈照明系統	80,000
33	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED 智慧控制工程與應用人才培訓班	80,000
34	台灣區電機電子工業同業公會	應用於 5G 無線通信系統之射頻前端電路設計	100,000
35	台灣區電機電子工業同業公會	自駕車 LiDAR 先進技術	100,000
36	台灣區電機電子工業同業公會	鋰電池特性與材料微結構及熱管理模擬實務	100,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
37	台灣區電機電子工業同業公會	人工智慧與機器學習應用實務	100,000
38	台灣區電機電子工業同業公會	電子產品構裝可靠度測試之原理與方法	100,000
39	台灣區電機電子工業同業公會	實現工業 4.0 智慧工廠解決方案	100,000
40	台灣區電機電子工業同業公會	汽車電子關鍵技術與設計實作探究	100,000
41	台灣區電機電子工業同業公會	高速傳輸介面最新技術演進與設計挑戰	100,000
42	台灣區電機電子工業同業公會	寬能隙半導體功率元件應用技術	100,000
43	台灣電路板協會	車用電子可靠度驗證與測試	80,000
44	台灣電路板協會	PCB 微切片實務與案列分享	100,000
45	台灣電路板協會	SMT、DIP 生產流程與問題分析	80,000
46	台灣電路板協會	AIAG-VDA FMEA 失效模式與效應分析	80,000
47	艾錫科技有限公司	人臉影像辨識之深度學習模型實作	100,000
48	財團法人車輛研究測試中心	電動車用電池包與電池管理系統設計	100,000
49	財團法人車輛研究測試中心	車聯網在 ADAS 的應用	100,000
50	財團法人車輛研究測試中心	區域控制網路(CAN)基礎與應用介紹	100,000
51	財團法人車輛研究測試中心	OBD-II 車上診斷系統原理、應用與系統開發實務	100,000
52	財團法人車輛研究測試中心	車電 EMC 設計與除錯實務探討	100,000
53	亞卓國際顧問股份有限公司	專利強化再生與迴避	96,000
54	亞卓國際顧問股份有限公司	新版 IATF16949:基礎知識與五大核心工具實務應用訓練	160,000
55	拓璞科技股份有限公司	智慧穿戴生醫應用與實務設計	100,000
56	拓璞科技股份有限公司	晶圓代工產業重點探討-先進製程與化合物半導體	100,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
57	拓璞科技股份有限公司	醫療數據與機器學習技術應用與實務分析	100,000
58	拓璞科技股份有限公司	積體電路製程流程與故障分析技術	100,000
59	拓璞科技股份有限公司	第三代半導體之氮化物高電子遷移率電晶體市場與技術	100,000
60	物聯雲股份有限公司	產線 AGV 應用(結合南台科大於台南開課)	140,000
61	物聯雲股份有限公司	設備預知維護保養(結合南台科大於台南開課)	140,000
62	物聯雲股份有限公司	智慧感測技術與設備聯網應用(結合南台科大於台南開課)	140,000
63	社團法人台灣電子設備協會	量子點材料技術人才培訓班	100,000
64	社團法人台灣電子設備協會	次世代創新顯示技術-Micro LED 技術與製程設備的開發人才培訓班	100,000
65	社團法人台灣電子設備協會	FO-WLP_PLP 封裝技術與設備材料發展動向人才培訓班	100,000
66	社團法人台灣電子設備協會	先進封裝 RDL 重佈線技術人才培訓班	100,000
67	社團法人台灣電子設備協會	半導體元件與製程技術人才培訓班	100,000
68	社團法人台灣電子設備協會	半導體檢測/量測技術人才培訓班	100,000
69	社團法人台灣電子設備協會	高精度雷射精微加工技術與半導體產業應用人才培訓班	100,000
70	社團法人台灣電子設備協會	FOPLP/FOWLP 先進封裝技術與設備材料發展動向人才培訓班	100,000
71	社團法人台灣電子設備協會	AOI 自動化光學檢測與嵌入式視覺應用人才培訓班	100,000
72	財團法人自強工業科學基金會	EMC 電磁相容技術精修班	80,000
73	財團法人自強工業科學基金會	高階 CIS(CMOS Image Sensors)原理及未來發展與應用	80,000
74	財團法人自強工業科學基金會	3D 多閘極電晶體技術與可靠度	100,000
75	財團法人自強工業科學基金會	5G 無線通訊射頻與毫米波積體電路設計	70,000
76	財團法人自強工業科學基金會	影像辨識於智慧自動化製造的應用	70,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
77	財團法人自強工業科學基金會	深度學習進行辨識並結合物聯網之應用(使用 tensorflow.js)	80,000
78	財團法人自強工業科學基金會	電源管理晶片設計	120,000
79	財團法人自強工業科學基金會	高速數位電路之訊號完整性(SI)設計與電磁干擾(EMI)效應	70,000
80	財團法人自強工業科學基金會	馬達驅動器設計與控制實務	70,000
81	財團法人自強工業科學基金會	OpenCV 影像處理與電腦視覺實作	70,000
82	財團法人自強工業科學基金會	TFT-LCD、OLED 與 Micro LED 顯示器驅動電路原理與設計	70,000
83	財團法人自強工業科學基金會	Python 程式設計及電腦視覺與機器學習技術實作	70,000
84	國立交通大學	射頻通訊系統分析與設計	100,000
85	國立交通大學	超取樣資料轉換器設計含實作	100,000
86	國立交通大學	低靜態電流線性穩壓器設計與切換式電源管理晶片	100,000
87	國立交通大學	類比積體電路	100,000
88	國立交通大學	半導體 IC 製程平台與產品工程-應用	100,000
89	國立交通大學	VLSI 訊號處理與 CNN 推論加速器晶片實現-進階應用(含實作)	100,000
90	國立交通大學	時脈資料回復	60,000
91	國立高雄大學	半導體封裝智能化製造技術	120,000
92	國立高雄大學	智能化製造與機器學習技術整合	72,000
93	新矽國際顧問股份有限公司	深度學習與影像辨識觀念與實務	48,000
94	新矽國際顧問股份有限公司	先進半導體製程整合工程 Photo-lithography	48,000
95	新矽國際顧問股份有限公司	電子產品 EMI/EMC 測試暨整改實務	48,000
96	新矽國際顧問股份有限公司	Introduction to flat panel display	48,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
97	新矽國際顧問股份有限公司	語音訊號處理-語音辨認及語音合成	48,000
98	新矽國際顧問股份有限公司	Introduction to speak recognition	48,000
99	新矽國際顧問股份有限公司	切換式電源管理晶片設計 DC-DC Converter IC Designs	48,000
100	新矽國際顧問股份有限公司	切換式電源管理晶片設計 DC-DC Converter IC Designs(進階)	48,000
101	新矽國際顧問股份有限公司	深度學習與語音辨識觀念與實務	48,000
102	雷蒙德管理顧問有限公司	HVIC 元件製造,設計與應用	100,000
103	雷蒙德管理顧問有限公司	人工智慧簡介與積體電路實現	100,000
104	雷蒙德管理顧問有限公司	IoT 簡介與應用	100,000
105	雷蒙德管理顧問有限公司	氮化鎵射頻功率放大器設計	100,000
106	雷蒙德管理顧問有限公司	SPC/QC7	100,000
107	雷蒙德管理顧問有限公司	DOE/統計分析手法	100,000
108	雷蒙德管理顧問有限公司	高科技經理人創新管理養成班	120,000

◎備取班級²

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費(元)
1	工業技術研究院	封裝與電路板層級之訊號完整性(SI)分析與實務	90,000
2	中華行動數位科技有限公司	AI 深度學習實戰	120,000
3	國立交通大學	下世代無線通訊之軟體定義射頻接收機設計	100,000
4	國立交通大學	SRAM Design in Nanoscale CMOS	100,000
5	國立交通大學	以行為模型驗證混合訊號系統之方法與實作	100,000
6	國立交通大學	3D IC 應用與製程簡介	100,000

² 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費(元)
7	財團法人自強工業科學基金會	EMC Layout 設計要領與實務分析	80,000
8	財團法人自強工業科學基金會	半導體可靠度工程與生命期預測	100,000
9	物聯雲股份有限公司	智慧感測技術與設備聯網應用	100,000
10	拓璞科技股份有限公司	高頻射頻 IC 設計實務	100,000
11	拓璞科技股份有限公司	LiDAR 與深度學習於自動駕駛領域的應用	100,000
12	拓璞科技股份有限公司	矽光子技術開發與 VCSEL 應用	100,000
13	拓璞科技股份有限公司	LiDAR 先進技術及未來發展趨勢	100,000
14	拓璞科技股份有限公司	從 ADAS/V2X 到自駕車之發展趨勢剖析及研發技術探索	100,000
15	英屬蓋曼群島商家庭傳媒(股)城邦分公司	5G+AI 智慧穿戴終端商機與設計	100,000
16	財團法人光電科技工業協進會	5G + AI 萬物互聯應用人才培訓班	100,000
17	財團法人光電科技工業協進會	5G 邊緣運算與 Data Center 人才培訓班	100,000
18	財團法人光電科技工業協進會	Micro LED 技術與製程設備的開發技術人才培訓班	100,000
19	財團法人光電科技工業協進會	數位光學在生醫領域的多元應用人才培訓班	100,000